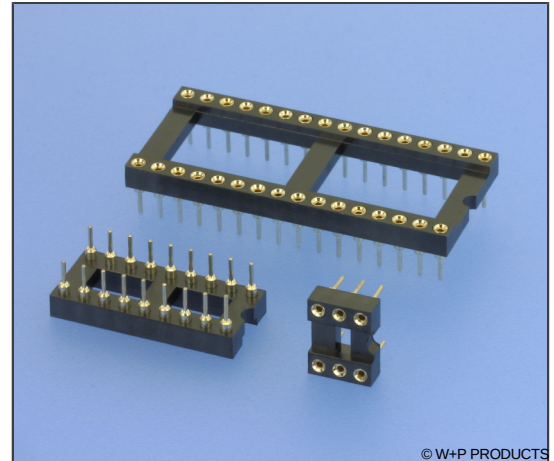
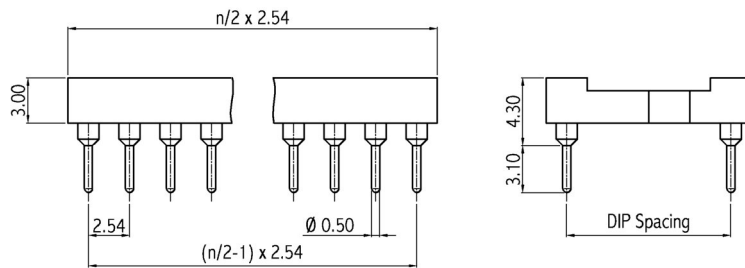


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
	Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass
	Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	6c
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering

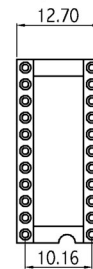


Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm oder Vierkantstifte 0,45x0,25.
For Ø 0.4 ... 0.56mm round pins or 0.45x0.25 square pins.

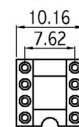


IC DIP Sockets 169C

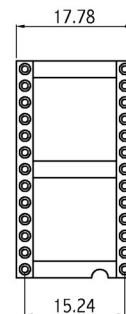
DIP Spacing 4



DIP Spacing 3



DIP Spacing 6



Series

169C

169C IC-Fassung
IC-Socket

Contacts*

14

06-24 28 =====>
20-24 28 32 =====>
24 28 32 36
40 42 48 =====>

DIP Spacing*

3

3 7,62mm
4 10,16mm
6 15,24mm

Sleeve Plating

50

50 Verzinnt (Standard)
Tin plated (Standard)

Clip Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

